

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Limbah.....	5
2.2 Limbah Cair Elektroplating.....	5
2.3 Logam Berat	6
2.4 Logam Tembaga (Cu).....	7
2.5 Elektrokimia	8
2.5.1 Elektrolit	9
2.5.2 Elektroda	10
2.6 Elektrodeposisi	10
2.7 Formaldehid.....	12
2.8 <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2 Bahan, Alat, dan Instrumentasi	15
3.3 Prosedur.....	15
3.3.1 Preparasi sampel	17
3.3.2 Preparasi elektroda.....	17

3.3.3 Pembuatan larutan standar tembaga (Cu)	17
3.3.4 Proses elektrodposisi dengan variasi tegangan dan waktu	18
3.3.5 Proses elektrodposisi dengan variasi konsentrasi agen pereduksi.....	18
3.3.6 Proses elektrodposisi logam tembaga (Cu) pada limbah cair elektroplating..	19
3.3.7 Karakterisasi	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Kurva Kalibrasi Standar Logam Cu	20
4.2 Proses Elektrodposisi pada Limbah Buatan	21
4.2.1 Proses elektrodposisi dengan variasi tegangan	22
4.2.3 Proses elektrodposisi dengan variasi konsentrasi agen pereduksi.....	25
4.3 Proses Elektrodposisi pada Limbah Cair Elektroplating.....	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN A	35
LAMPIRAN B	37
LAMPIRAN C	43

